



2005年6月1日

《報道資料》

ブロードコム、先進ワイヤレス・ステレオ・ヘッドセット向けの 高性能Bluetooth[®]チップを発表

～ブロードコムがZeevo社買収を通じて取得した技術により、
エンドツーエンドEDR (Enhanced Data Rate) ワイヤレス・ステレオ機能を追加～

台湾・台北 – 2005年5月31日発表

有線および無線ブロードバンド通信向け半導体ソリューションのリーダー企業であるブロードコム・コーポレーション (Nasdaq: BRCM) は、台湾の台北で開催されている『Computex 2005』において、ワイヤレス・ステレオ・ヘッドセット向けに最適化されたシングルチップBluetooth[®]ソリューションを発表しました。この新しいチップは、一層優れたオーディオ忠実性と長いバッテリー寿命を提供することでエンドユーザー体験を向上させるBluetooth EDR (Enhanced Data Rate) 機能を備えています。この新しいデバイスは、ブロードコムが提供する初のステレオ・ヘッドセット専用Bluetoothチップで、同社が最近買収したワイヤレス・オーディオ専門企業のZeevo社の技術を利用した最初の製品の発表となります。

エレクトロニクス・メーカーは、携帯電話、PDA製品、およびデジタル音楽ファイルを再生できる他のデバイスなど、ますます多様化する製品に先進デジタル・オーディオ機能を提供しています。これらのデバイスで、Bluetoothワイヤレス技術の利用は拡大しており、顧客は利便性に優れ、どこでも聴けるリスニング体験を享受できます。メーカーはBluetooth技術を利用した製品を発表しており、Bluetoothワイヤレス・ヘッドセット市場は著しい成長を遂げています。調査会社InStat/MDRは、ワイヤレス・ヘッドセットの出荷数が2008年までに年間9,000万個近くにまで拡大すると予測しています。

ブロードコムのBluetooth製品マーケティング担当シニア・ディレクターのスコット・ビバウド (Scott Bibaud) は、「当社のBluetooth専門シングルチップ・ソリューションは、優れた高性能を提供し、ワイヤレス・デバイス・ユーザーに高度な機能を提供する製品の迅速な開発を促進します。当社の新しいBCM2037チップは、最適なステレオ・オーディオ体験をもたらす先進デジタル・オーディオ・プロセッシングとバッテリーの長寿命化を可能にするEDRなど、ワイヤレス・ステレオ・ヘッドセットに必要な主要機能を統合しています」と述べています。

ブロードコムのBlutonium[®] BCM2037ステレオ・チップには、Bluetoothベースバンドと無線を搭載しているほか、ワイヤレス・ステレオ・ヘッドセットのユーザーに最高水準のオーディオ体験を提供するよう設計されたBluetooth技術ベースの最適化されたアーキテクチャを導入しています。特に、BCM2037はEDR未対応Bluetoothチップ (1Mbps) の3倍のデータ転送速度 (3Mbps)

を提供するEDR技術を搭載する業界初のヘッドセット専用チップとなります。当ソリューションを補完するために、ブロードコムは既に携帯電話やその他のモバイル・デバイスなどのホスト製品向けのEDRチップ（BCM2045）も発表しています。高速化されたスループットにより、消費電力は大幅に低減され、BCM2037搭載ヘッドセットのバッテリー寿命を飛躍的に向上させます。

高速化されたデータ転送速度を持つEDRは、以下のユーザー利点を提供します。

- システム側でパケットの再転送とより高速なバッファ再蓄積を行えるため、パケットの欠落やオーディオの遮断を最小限に抑え、ヘッドセットとホスト間の接続をより一層安定させます。
- 一台のBCM2037搭載デバイスから、MP3プレイヤー、電話、およびパーソナル・コンピュータなどの複数のBluetooth搭載デバイスへの同時接続・維持が可能です。
- 単一のソースから複数のヘッドセットにステレオ・オーディオをストリーミング配信できる機能を提供します。
- ヘッドセットに転送できるオーディオ・ファイルの種類を制限することなく、完全な非圧縮ステレオ・オーディオを転送することが可能です。

最適化されたステレオ・オーディオ・アーキテクチャ

ステレオ・ワイヤレス・ヘッドセットのメーカー特有の要求に応えるため、BCM2037はステレオ・アプリケーションに特化したオーディオ処理機能を提供する独自のアーキテクチャを備えています。この設計は、オーディオ処理効率を改善して消費電力を低減し、Bluetoothによる接続を介して優れたステレオ体験を提供します。このチップには、オンボードのARM7™プロセッサが搭載されており、メーカーは使い慣れたソフトウェア開発環境を利用して一つの製品から他の製品に容易にソフトウェアを移植することができるため、開発期間の短縮と製品の迅速な市場投入が可能になります。

出荷時期

BCM2037は現在、早期より問い合わせを受けていたブロードコムの顧客にサンプル出荷されており、2005年第3四半期には量産出荷される予定です。

ブロードコムについて

Broadcom Corporation（ブロードコム・コーポレーション）は、有線および無線ブロードバンド通信向け半導体の世界的なリーダー企業です。当社の製品により、家庭、会社、および移動中における高速データ、高解像度ビデオ、音声、およびオーディオの融合が実現されます。ブロードコムは、コンピュータ、ネットワーク機器、デジタル・エンターテインメント、およびブロードバンド・アクセス製品、およびモバイル・デバイスのメーカーに、業界で最も広範な最先端

system-on-a-chipおよびソフトウェア・ソリューションを提供しています。これらのソリューションは、ブロードコムのミッションである“Connecting everything[®]”を支えています。

ブロードコムは、世界最大のファブレス半導体企業で、年間売上は20億ドルを上回っています。ブロードコムは、本社を米国カリフォルニア州アーバインに構え、北米、アジア、および欧州に拠点および研究施設を擁しています。詳細情報は、www.broadcom.comに掲載されています。

*Broadcom[®]、パルスのロゴ、Connecting everything[®]、Connecting everythingのロゴ、およびBlutionium[®]は、米国、EU、およびその他の国におけるBroadcom Corporationおよび(または)同社の関連組織の商標です。Bluetooth[®]は、Bluetooth SIGの商標です。ARM[™]は、ARM Holding Co. Ltd.の商標です。記載されているその他のすべての商標は、各所有企業に帰属します。

本件に関する報道関係者の方のお問い合わせ先

ブロードコム ジャパン株式会社
Sander Cheung
Tel: 03-5908-3041 / Fax: 03-5908-3042
Email: scheung@broadcom.com

有限会社アンビローク
Tel: 03-3384-3434 / Fax: 03-5204-9180
Email: broadcom@ambilogue.com